Inicjatywa spotkania przedstawicieli polskich ośrodków badawczych zajmujących się pomiarem naprężeń w materiałach z wykorzystaniem technik dyfrakcji rentgenowskiej powstała wiosną 2012r w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Celem takiego spotkania była potrzeba skonsolidowania środowiska badaczy zajmujących się identyfikacją tej użytecznej charakterystyki materiałów, jaką jest stan odkształcenia sprężystego ich mikrostruktury – naprężeń własnych. Zarówno poziom, jak i konfiguracja utrzymujących się naprężeń własnych w znacznym stopniu warunkują właściwości eksploatacyjne elementów konstrukcyjnych. Stąd też, poznanie ww. charakterystyki jest bardzo istotne przy projektowaniu materiałów czy ocenie czasu bezpiecznej eksploatacji określonych konstrukcji. Ponieważ techniki doświadczalne, jak i rozwiązania metodologiczne z zakresu identyfikacji naprężeń są wciąż udoskonalane, wymiana informacji oraz potrzeba weryfikacji własnych osiągnieć stały się naturalną potrzebą badaczy w przedmiotowym zakresie. Na pierwszym zebraniu w Instytucie Lotnictwa postanowiono kontynuować inicjatywę tego typu spotkań służących:

- wymianie dobrych praktyk pomiarowych,
- wymianie informacji na temat metodologii pomiarowej,
- prezentacji zagadnień podejmowanych przez poszczególne zespoły naukowe,
- prezentacji wyników badań i ich aplikacji w praktyce.

Tak narodziła się idea *Sympozjum Pomiaru i Interpretacji Naprężeń* SPINA.

Kolejne spotkania, które odbyły się w Warszawie (Instytut Lotnictwa, maj 2012), Skawinie (OML/IMN, grudzień 2012), Częstochowie (Politechnika Częstochowska, listopad 2013),

Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska, listopad 2014), Łodzi (Politechnika Łódzka, czerwiec 2015) utwierdziły ich uczestników w potrzebie kontynuowania SPINA.

W roku 2016 planowana jest kolejna SPINA, tym razem w Krakowie (IMIM PAN). Dokładne informacje będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej www.imim.pl

Prof. dr hab. inż. Jan Bonarski

IMIM PAN, Kraków

Miejsce

Więcej informacji wkrótce.

Program

Więcej informacji wkrótce.

Rejestracja

Więcej informacji wkrótce.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji wkrótce.